

(上接B9版)

注:公司与上述客户交易的单片晶圆定价为单片晶圆有效管芯数*管芯价格,公司与吉林华微电子半导体FR MOSFET主要供货方,吉林华微电子为IDM公司,相较于公司具有一定的成本优势,根据吉林华微电子的年报数据来看,其2025年半导体分立器件的毛利率为24.52%,远高于公司的功率器件14.27%的毛利率。

综上所述,公司向高品质半导体的产品定价具有公允性,毛利率较低具有合理性。

三、近三年前五大供应商情况,包括名称、成立时间、合作历史、采购内容、采购金额、关联关系等,说明变动合理性:

(一)近三年前五大供应商情况

公司2025年度前五大供应商情况如下:

序号	供应商	采购业务	采购金额	采购占比	采购具体产品	是否关联方
1	西安微晶电子有限公司	晶圆代工	5,739.49	19.39%	平面MOSFET,FR MOSFET	否
2	无锡晶芯科技有限公司	晶圆代工、掩膜版	5,703.97	19.27%	平面MOSFET,隔离型固态继电器,功率驱动	否
3	芯恩(青岛)集成电路有限公司	晶圆代工、掩膜版	2,456.32	8.30%	沟槽型MOSFET,屏蔽栅MOSFET	否
4	中国电子科技集团下属企业	外延片	2,187.60	7.39%	外延片	否
5	供应商乙-同一控制下企业	晶圆代工、掩膜版,封装服务	1,439.35	4.86%	电源管理,功率驱动	否
合计			17,526.72	59.21%		

单位:万元

公司2024年度前五大供应商情况如下:

序号	供应商名称(同控)	采购业务	采购金额	采购占比	采购具体产品	是否关联方
1	西安微晶电子有限公司	晶圆代工	2,965.43	22.67%	平面MOSFET,FR MOSFET	否
2	无锡晶芯科技有限公司	晶圆代工、掩膜版	2,549.78	19.49%	平面MOSFET,隔离型固态继电器,功率驱动	否
3	中国电子科技集团下属企业	外延片、晶圆代工	1,041.62	7.90%	外延片,SiC SBD	否
4	芯恩(青岛)集成电路有限公司	晶圆代工、掩膜版	896.46	6.85%	沟槽型MOSFET,屏蔽栅MOSFET	否
5	广东芯粤能半导体有限公司	晶圆代工、掩膜版	673.46	5.15%	SiC MOSFET	否
合计			8,126.77	62.12%		

单位:万元

公司2023年度前五大供应商情况如下:

序号	供应商名称(同控)	采购业务	采购金额	采购占比	采购具体产品	是否关联方
1	西安微晶电子有限公司	晶圆代工	4,543.19	24.75%	平面MOSFET,FR MOSFET	否
2	供应商乙-同一控制下企业	晶圆代工、掩膜版	3,177.32	17.31%	电源管理,隔离型固态继电器,功率驱动	否
3	中国电子科技集团下属企业	外延片、晶圆代工	1,784.17	9.72%	外延片,SiC SBD	否
4	深圳中电投资有限公司	晶圆代工	1,637.14	8.92%	沟槽型MOSFET	否
5	中晶科技(宁波)半导体材料有限公司	外延片	1,557.82	8.49%	外延片	否
合计			12,699.64	69.19%		

由上表来看,公司2023年至2025年前五大供应商占比分别为69.19%、62.12%、59.21%,前五大供应商的采购占比呈下降趋势,前五大供应商均与公司不存在关联关系,关联方采购金额0元,公司对单个供应商的采购金额未超过年度采购业务的50%,不存在供应商集中度偏高的情形。

(二)近三年前五大供应商合作历史及变动情况

公司近三年前五大供应商变动情况如下:

序号	供应商名称(同控)	2025年度	2024年度	2023年度	成立时间
1	西安微晶电子有限公司	前五大供应商	前五大供应商	前五大供应商	2016年1月
2	无锡晶芯科技有限公司	前五大供应商	前五大供应商	前五大供应商	2023年4月
3	芯恩(青岛)集成电路有限公司	前五大供应商	前五大供应商	前五大供应商	2018年4月
4	中国电子科技集团下属企业	前五大供应商	前五大供应商	前五大供应商	2002年2月
5	供应商乙-同一控制下企业	前五大供应商	前五大供应商	前五大供应商	2004年3月
6	广东芯粤能半导体有限公司	前五大供应商	前五大供应商	前五大供应商	2023年5月
7	深圳中电投资有限公司	前五大供应商	前五大供应商	前五大供应商	1982年5月
8	中晶科技(宁波)半导体材料有限公司	前五大供应商	前五大供应商	前五大供应商	2019年11月

1.西安微晶电子有限公司自2016年起与公司建立合作,近三年均为公司第一大供应商,主要为公司提供晶圆代工,未发生变更。

2.公司自2023年起与无锡晶芯科技有限公司建立合作,2024年起进入前五大供应商,主要系公司需求增加采购量所致。

3.公司自2022年起与芯恩(青岛)集成电路有限公司建立合作,主要代工沟槽型MOSFET晶圆,2024年因该类产品销售增加,采购量上升进入前五大供应商。

4.公司自2021年上半年开始与中国电子科技集团下属企业建立合作,2021年上半年开始,公司与西安微晶的晶圆委外模式由直接委外转变为带料委外,带料委外模式下,公司自行采购外延片,再委托西安微晶做其进行加工。上述代工模式的变化导致公司的外延片采购金额大幅增加,近三年均为公司前五大供应商,未发生变更。

5.供应商乙合作历史及变动情况豁免披露

6.公司自2023年起与广东芯粤能半导体有限公司建立合作,主要委托其代工碳化硅MOSFET晶圆,2024年因代工量增加进入前五大供应商,2025年因无锡芯享纳入合并范围,其他供应商进入前五大供应商,其未进入前五大供应商。

7.公司自2022年起与深圳中电投资有限公司建立合作,主要委托其代理采购韩国东部制造的MOSFET晶圆,由于韩国东部属于境外代工厂,中电投资可提供代理报关、货物转换等功能,上市公司源杰科技、东微半导体均披露其通过中电投资采购境外供货产品,2023年公司采购量增加,进入前五大供应商,2024年采购量有所减少,其退出前五大供应商。

8.公司自2021年起与中晶科技(宁波)半导体材料有限公司(原名:中电(华伦)半导体有限公司,2025年9月完成更名)建立合作,主要向其购买碳化硅外延片,2023年为前五大供应商,公司自2023年下半年公司委托芯粤能代工的碳化硅MOSFET晶圆,碳化硅外延片由芯粤能采购,故公司向中电采购的数量逐步减少。

四、结合应付账款主要供应商名称、采购内容及金额等,说明应付账款大幅增加的原因和合理性。

公司2025年末应付账款余额为5,926.58万元,较2024年末余额2,185.69万元增加了3,740.89万元,应付账款增加主要系采购规模上升导致的应付账款增加,应付账款主要变动情况如下:

单位:万元	供应商名称(同控)	2025年期末余额	2024年期末余额	变动金额	变动内容
	芯恩(青岛)集成电路有限公司	1,725.31	32.30	1,693.00	晶圆代工、掩膜版
	西安微晶电子有限公司	773.57	606.52	167.05	晶圆代工
	无锡晶芯科技有限公司	601.52	173.41	428.12	晶圆代工、掩膜版
	中国电子科技集团下属企业	544.01	179.04	364.97	外延片
	江苏捷捷微电子股份有限公司同一控制下企业	278.96	3.25	275.70	晶圆
	苏州捷创科技有限公司	138.63	138.63	0.00	设备资产
	合计	4,062.00	988.52	3,073.48	

芯恩(青岛)集成电路有限公司2025年期末余额较上期增加1,693.00万元,主要系采购增加以及调整结算方式所致,2024年度期末为量产产品批次订单总额约15%,剩余账龄30天;2025年变更为量产产品无需支付订单预付款,账龄整体调整为30天。

西安微晶电子有限公司,无锡晶芯科技有限公司,江苏捷捷微电子股份有限公司同一控制下企业的应付账款增加主要系当期采购增加所致。

中国电子科技集团下属企业2025年期末余额较上期增加364.97万元,主要系2025年采购增加,同时2025年度付款账期较上期延长了30天所致。

苏州捷创科技有限公司为2025年度新增的设备供应商,期末应付款增加系尚未到合同约定的支付节点。

五、年审会计师核查意见

1.核查程序:

(1)获取近三年收入明细表,采购明细表,并向管理层、销售及运营部门、公司主要客户、供应商变动的明细,并结合公司实际业务情况,分析变动的合理性;

(2)获取公司的关联方清单,比较公司前十大客户、前五大供应商中关联方交易情况;

(3)向公司了解与历年前十大客户、前五大供应商的合作历史及交易变动原因;

(4)获取公司2025年前十大客户的近三年的销售明细,比较分析变动情况,与同类产品其他客户价格差异情况,分析相关产品的价格公允性、毛利率合理性;对第一大客户其他客户价格差异验证了合同、发货单、签收单,查看等细节资料,验证比例为41.12%;

(5)获取公司2025年应付账款余额增加的主要供应商情况,并了解分析其原因。

2.核查意见:

经核查,年审会计师认为:(1)公司已补充说明近三年公司前十大客户和前五大供应商的相关情况,变动具有合理性;

(2)公司对第一大客户定价公允、毛利率合理,其订单签订及产品交付时间、收入确认依据及时点、历年合作情况及收入波动原因与其他FR MOSFET的客户趋势一致;

(3)公司应付账款增加具有合理性原因。

六、持续督导机构核查意见

1.核查程序:

(1)获取近三年收入明细表,采购明细表,并向管理层、销售及运营部门、公司主要客户、供应商变动的明细,并结合公司实际业务情况,分析变动的合理性;

(2)获取公司的关联方清单,比较公司前十大客户、前五大供应商中关联方交易情况;

(3)向公司了解与历年前十大客户、前五大供应商的合作历史及交易变动原因;

(4)获取公司2025年前十大客户的近三年的销售明细,比较分析变动情况,与同类产品其他客户价格差异情况,分析相关产品的价格公允性、毛利率合理性;

(5)获取公司2025年应付账款余额增加的主要供应商情况,并了解分析其原因。

2.核查意见:

(1)公司已补充说明近三年公司前十大客户和前五大供应商的相关情况,变动具有合理性;

(2)公司对第一大客户定价公允、毛利率合理,其订单签订及产品交付时间、收入确认依据及时点、历年合作情况及收入波动原因与其他FR MOSFET的客户趋势一致;

(3)公司应付账款增加具有合理性原因。

公司主要应收账款账龄均在1年以内,部分客户订单出现逾期情况,公司自身审批流程较长,下游客户回款较慢,自身的资金规划等因素导致未按约定日期付款,报告期内逾期客户回款为高可靠领域客户,该部分客户信誉情况良好,信誉度高,与公司长期持续合作,且款项回收及时,不存在客户历史评价恶化、大额应收账款无法收回的风险较小,结合公司客户性质和过往合作历史评估,本期对部分长期合作的优质客户(包括高可靠及其他重点客户)优化了结算周期。

客户D1为高可靠领域客户,其自身审批流程较长,自身的资金规划等因素导致货款逾期时间较长,但客户资信情况良好,信誉度高,与公司长期持续合作,不存在客户付款恶化的风险,大额应收账款无法收回的风险较小。

客户F,盛廷微电子(无锡)有限公司因下游客户回款较慢,自身的资金规划等因素导致未按约定日期付款,从过往合作历史评估,回款风险可控。

4.2025年末应收账款较2024年变动情况如下:

项目	2025年度	2024年度	变动
营业收入	25,456.78	13,013.44	95.62%
应收账款	12,093.46	8,497.43	49.38%
应收账款与营收比重	49.86%	65.30%	-23.64%

2025年末应收账款余额为12,093.46万元,较2024年末应收账款余额8,497.43万元增加了3,596.03万元,主要系2025年收入较2024年大幅增加导致应收账款增加,应收账款增长幅度远小于营业收入增加幅度,期末应收账款占当期营业收入比重由上期的65.3%下降至本期的49.86%,此外本期因无锡芯享纳入合并范围导致应收账款增加1,150.48万元。

综上,2025年收入较2024年大幅增加,且无锡芯享于本期纳入合并范围导致2025年末应收账款余额较2024年大幅增加,具有合理性。

(三)坏账准备计提是充分的

公司2025年末应收账款账龄主要为1年以内,占比92.49%,应收账款账龄结构较好,应收账款账龄及坏账准备具体情况如下:

单位:万元	2025年末		2024年末	
账龄	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)
1年以内	11,740.67	92.49	587.03	5.00
1-2年	949.66	7.82	189.93	20.00
2-3年	3.13	0.01	1.56	0.00
合计	12,693.46	100.00	778.53	6.13

由上表可以看出,公司于2025年度以上应收账款占比呈下降趋势,公司近几年未发生应收账款无法收回的情形,2025年末应收账款预期逐步回收,截至目前未出现无法收回的情形。

从公司应收账款信用损失模型角度来看,公司根据账龄和预期信用损失率计提减值损失,公司预期信用损失率与同行业公司相比不存在重大差异,具体情况如下:

公司	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
士兰微	5.00%	10.00%	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%
华微电子	1.58%	21.51%	54.26%	85.41%	100.00%	100.00%
新洁能	5.00%	10.00%	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%
东微半导体	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%
平均值	4.10%	15.38%	41.07%	96.35%	100.00%	100.00%
公司	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%

综上,公司应收账款账龄状况较好,未出现应收账款无法收回的情形,公司账龄组合计提比例与同行业公司相比不存在重大差异,公司按照账龄组合于2025年末已计提

客户	电源管理	330.07	620.00	385.67	151.50	—
四川升华电源科技有限公司	电源管理	417.26	281.26	103.37	102.15	0.21
客户D1	电源管理、电机驱动	540.94	277.04	14.00	—	0.69
宁波群微电子股份有限公司	隔离型固态继电器;平面MOSFET	1,710.49	577.17	16.88	358.16	2.13
客户K	电源管理	259.40	20.47	70.00	80.47	—
客户G	电源管理	149.62	120.00	—	40.00	0.34
芜湖华元微电子有限公司	沟槽MOSFET	1,052.98	345.35	19.82	324.26	1.27
深圳市南微电子科技有限公司	电源管理	1,100.08	104.55	64.92	44.04	552.47
客户D2	电源管理	88.14	104.55	34.75	—	0.10
小计		6,463.64	2,248.32	1,571.64	1,029.52	1,234.89

由上表可见,公司于2025年度收到上述客户背书或开具的银行承兑汇票2,248.32万元,商业承兑汇票1,571.64万元,合计3,819.96万元。上述承兑汇票共计215张,票据涉及开票单位共计166家,具体情况如下:

项目	数量	收取金额	开票单位	单笔票据最大开票金额
银行承兑汇票	147	2,248.32	主要为宁波群微电子股份有限公司,深圳市南微微科技有限公司等客户,共计134家	200.00
商业承兑汇票	166	1,571.64	主要为高可靠领域客户,共计32家,包括客户A、四川升华电源科技有限公司、客户D1等	300.00
合计	313	3,819.96		

公司收到的承兑汇票主要用于背书、到期托收或贴现,截至2026年4月30日止,已到期的承兑汇票未出现无法兑付情形。

(二)坏账准备计提是否充分,商业承兑汇票坏账计提比例较上年大幅下降的原因

2024年末,2025年末应收票据坏账计提如下:

项目	账龄	期末余额	减值准备	减值比例	期初余额	期初减值准备
银行承兑汇票	1-6个月	948.67	18.97	1.99%	929.70	5.00
商业承兑汇票	1-6个月	1,838.91	180.18	9.80%	1,657.73	2,815.59
其中:1年以内		1,259.69	62.53	1,188.16	741.41	37.07
1-2年		588.22	117.64	20.18%	2,074.18	414.84
合计		2,787.59	199.15	2,588.44	3,065.51	456.91

注:上表中商业承兑汇票的账龄为将商业承兑汇票还原为应收账款并持续计算的账龄。

由上表可见,2025年末商业承兑汇票期末余额较2024年末减少976.68万元,坏账准备减少271.73万元,商业承兑汇票坏账准备减少系还原应收账款后持续计算的1-2年账龄余额较2024年末减少41,485.96万元所致。

公司商业承兑汇票主要来自高可靠领域客户,该部分客户或其票据出票人/承兑人通常信用较好,截至目前未出现商业承兑汇票到期后无法完成托收的情形,公司在考虑商业承兑汇票的信用减值时,除考虑承兑人、出票人的信用因素外,同时还将商业承兑汇票还原为应收账款并根据还原后应收账款账龄情况计提信用减值损失。

2025年末,公司持有商业承兑汇票余额1,838.91万元,将其还原至应收账款后的账龄分别为1年以内1,250.69万元,1-2年588.22万元,还原后账龄为1-2年应收账款余额较2024年末减少1,485.96万元,使得2025年末应收票据计提信用减值损失199.15万元,计提比例0.80%,较2024年末的16.05%有所减少。

综上,根据公司应收票据主要客户的基本情况、还款能力、信用情况、兑付情况,以及公司账龄结构角度来看,公司于2025年末计提应收账款坏账准备199.15万元,应收票据坏账计提具有充分性,商业承兑汇票坏账计提比例较上年大幅下降具有合理性。

二、列示应收账款主要欠款方及账龄在1年以上的欠款方名称、形成时间、交易内容及背景、账面余额、减值计提及转回情况、客户信用评级、信用政策是否变化、是否逾期以及逾期主要原因,说明应收账款大幅增加的原因及合理性,是否存在放宽信用政策增加收入的情况。

(一)应收账款余额构成

单位:万元	账龄	2025年末余额	2024年末余额	变动金额
1年以内		11,740.67	7,413.40	4,327.27
1-2年		949.66	1,084.03	-134.36
2-3年		3.13	—	3.13
合计		12,693.46	8,497.43	4,196.03
减:坏账准备		1,718.95	587.48	1,131.47
合计		10,974.51	7,909.95	3,064.56

由上表可见,2025年末应收账款账面余额为12,693.46万元,较2024年末账面余额8,497.43万元增加4,196.03万元,主要系2025年收入较2024年大幅增加导致应收账款增加,此外本期因无锡芯享纳入合并范围导致应收账款增加1,150.48万元。

(二)应收账款主要欠款方及账龄在1年以上的欠款方情况

客户	形成时间	交易内容	期末余额	2025年末余额占比
宁波群微电子股份有限公司	2025年度	隔离型固态继电器;平面MOSFET	1,319.46	10.39%
西安微晶电子有限公司	2025年度	沟槽型MOSFET	1,126.93	8.88%
客户H	2024-2025年度	电机驱动	1,076.92	8.48%
客户I	2025年度	电机驱动	1,063.66	8.38%
客户D1	2024-2025年度	电源管理、电机驱动	863.03	6.80%
客户B	2025年度	电源管理	694.42	5.47%
瑞森半导体科技(广东)有限公司	2025年度	电源管理、平面MOSFET,电源管理	569.31	4.49%
四川华电电源科技有限公司	2025年度	电源管理	357.58	2.82%
客户E	2025年度	隔离型固态继电器	325.68	2.57%
晶艺半导体有限公司	2025年度	FR MOSFET	287.82	2.27%
小计			7,837.80	61.75%
应收账款余额			12,693.46	

注:上表列示了余额前十大客户;

注2:上述客户同时为历年前十大客户,交易背景详见前文“二、关于主要客户及供应商”之“(一)近三年前十大客户合作历史及变动情况”,下表明。

单位:万元	客户	形成时间	交易内容	期末余额	账龄	期末坏账准备余额
	客户H	2024-2025年度	电源管理	1,076.92	65.96	421.76
	客户D1	2024-2025年度	电源管理、电机驱动	863.03	611.26	251.97
	客户B	2025年度	电机驱动	1,063.66	611.26	80.92
	盛廷微电子(无锡)有限公司	2024年度	沟槽MOSFET	153.00	153.00	30.60
	合计			2,092.95	1,266.21	826.74

注:上表列示了应收账款账龄在1年以上的欠款方名称、形成时间、交易内容及背景、账面余额、减值计提及转回情况、客户信用评级、信用政策及逾期情况。

三、说明应收账款主要欠款方及账龄在1年以上的欠款方交易内容、信用政策及逾期情况

客户	交易内容	信用政策	逾期情况
宁波群微电子股份有限公司	隔离型固态继电器;平面MOSFET	20号起账,2个月月底收款	20号起账,2个月月底收款
芜湖华元微电子有限公司	沟槽MOSFET	25号起账,3个月月底收款	25号起账,3个月月底收款
客户H	电机驱动	月底起账,1个月月底收款	月底起账,1个月月底收款
客户I	电机驱动	25号起账,5个月月底收款	月底起账,5个月月底收款
客户D1	电源管理、电机驱动	25号起账,1年后月底收款	月底起账,6个月月底收款
客户B	电源管理	月底起账,4个月月底收款	月底起账,2个月月底收款
晶艺半导体科技(广东)有限公司			